

电子

智能驾驶竞争白热化，关注汽车电子投资机会

投资要点：

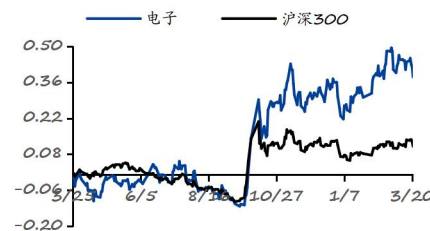
- **智能驾驶的竞争日趋白热化。**今年2月比亚迪推出“天神之眼”智驾系统，将旗下21款车型升级到“高阶智驾”版本，并且将智驾车型的入门价格下探到7万元的“海鸥”系列。同一时间其他厂商快速跟进。吉利汽车发布智驾解决方案“千里浩瀚”，覆盖吉利全系不同价位的车型。长安汽车宣布从今年起将不再开发非智能化新产品，并且将在今年8月在10万元级别车型搭载激光雷达。在最近一周，奇瑞也加入了竞争。3月18日奇瑞宣布，将争取2025年实现全品牌全系车型搭载“猎鹰智驾”智能化方案。并且将“智驾平权”的车型下探到6万元级别。小型车奇瑞小蚂蚁推出智驾版，售价仅6.59万元。
- **除了智驾以外，快速充电也成为新的竞争热点。**3月17日，比亚迪发布了最新的超级e平台技术，推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。公司在会上提出让电动车的充电时间和燃油车加油时间一样短的“油电同速”概念。公司在充电速度上实现了充电功率1兆瓦（1000kW），实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里，达到闪充5分钟，畅行400公里。
- **智能驾驶和快充技术的突破有望带动新能源车企的“军备竞赛”。建议关注两方面的投资机会：**
 - **一是视觉和激光雷达方向。**在智能驾驶加速落地的进程中，车载摄像头作为中高阶智驾方案中的传感器，正经历单车搭载量提升和技术升级的双重变革。而CIS是摄像头模组的核心器件，其价值量约占汽车摄像头模组总成本的50%，是智能驾驶过程实现高分辨率、适应复杂光照及环境条件、满足城市NOA等场景的关键。CIS需求量有望得到快速增长。而且随着技术进步与规模化效应的双重驱动，原来在高端车型上搭载的激光雷达也不再高不可攀。如长安汽车宣布今年8月将在10万级车型搭载激光雷达。未来激光雷达也能进入平价时代。
 - **二是碳化硅功率器件方向。**碳化硅功率器件因为具备耐高压、耐高频、耐高温等特点，可以显著提高电池充电速度和整车运行效率。而新能源车的高压架构将推动碳化硅渗透率的提升。如比亚迪最新发布的超级e平台，就是全球首个量产的乘用车“全域1000V高压架构”，即将电池、电机、电源、空调等全系高压部件都做到了1000V。为匹配超高功率充电，公司自研并量产了全新一代车规级碳化硅功率芯片。该芯片的电压等级高达1500V，是行业首次量产应用的、最高电压等级的车规级碳化硅功率芯片。随着行业整体高压架构迭代升级，从400V到800V，再到1000V以上，未来适用于高压环境的碳化硅器件方案有望在车企的竞争过程中加快渗透。
 - **建议关注以下方向的公司：****视觉和激光雷达方向：**韦尔股份、思特威、晶方科技、舜宇光学科技、联创电子、宇瞳光学、欧菲光、速腾聚创、禾赛科技、炬光科技、永新光学等。**碳化硅方向：**天岳先进、时代电气、斯达半导、士兰微、三安光电、闻泰科技等。

风险提示

智能驾驶终端需求不及预期；地缘政治风险；行业景气不及预期；行业竞争加剧风险。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



相关报告

- 1、【华福电子】存储大厂涨价，关注存储产业链——2025.03.17
- 2、【华福电子】行业动态跟踪：北方华创&芯源微强强联合，半导体设备迈入新阶段——2025.03.11
- 3、【华福电子】行业动态跟踪：吉利接棒推动平权智驾，降价增配加速智驾下沉——2025.03.05

正文目录

1 本周市场表现 3

1.1 电子板块本周表现 3

1.2 SW 电子个股本周表现 4

1.3 电子板块估值分析 4

2 行业动态跟踪 5

1) 2024 年我国数字产业 完成业务收入 35 万亿元 5

2) 上海集成电路产业投资基金三期成立，出资额 5.3 亿元 6

4) 苏州加快发展 AI 芯片产业专项政策将出炉，最高亿元资助 8

5) 斯达半导体重庆车规级模块生产基地项目封顶，未来产能将达 180 万片 11

6) 投资已超 10 亿元，宁波冠石半导体光掩模版制造项目通线 12

7) 里程碑！京东方华灿 Micro LED 工厂产品正式交付 12

8) 华大九天拟购买芯和半导体控股权 13

9) 汇顶科技任命柳玉平为新总裁 13

10) 小米计划扩建北京第二电动汽车工厂，年交付目标提升至 35 万辆 14

11) 魅杰光电获数千万元融资，聚焦半导体量检测设备赛道 14

12) 松应科技完成数千万元天使轮融资，系实时物理 AI 仿真平台公司 15

3 公司动态跟踪 16

4 风险提示 18

图表目录

图表 1: SW 各行业板块本周市场表现 3

图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅 3

图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%) 错误！未定义书签。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%) 4

图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%) 4

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%) 4

图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM) 5

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM) 5

图表 9: 过去一周股东增减持更新 16

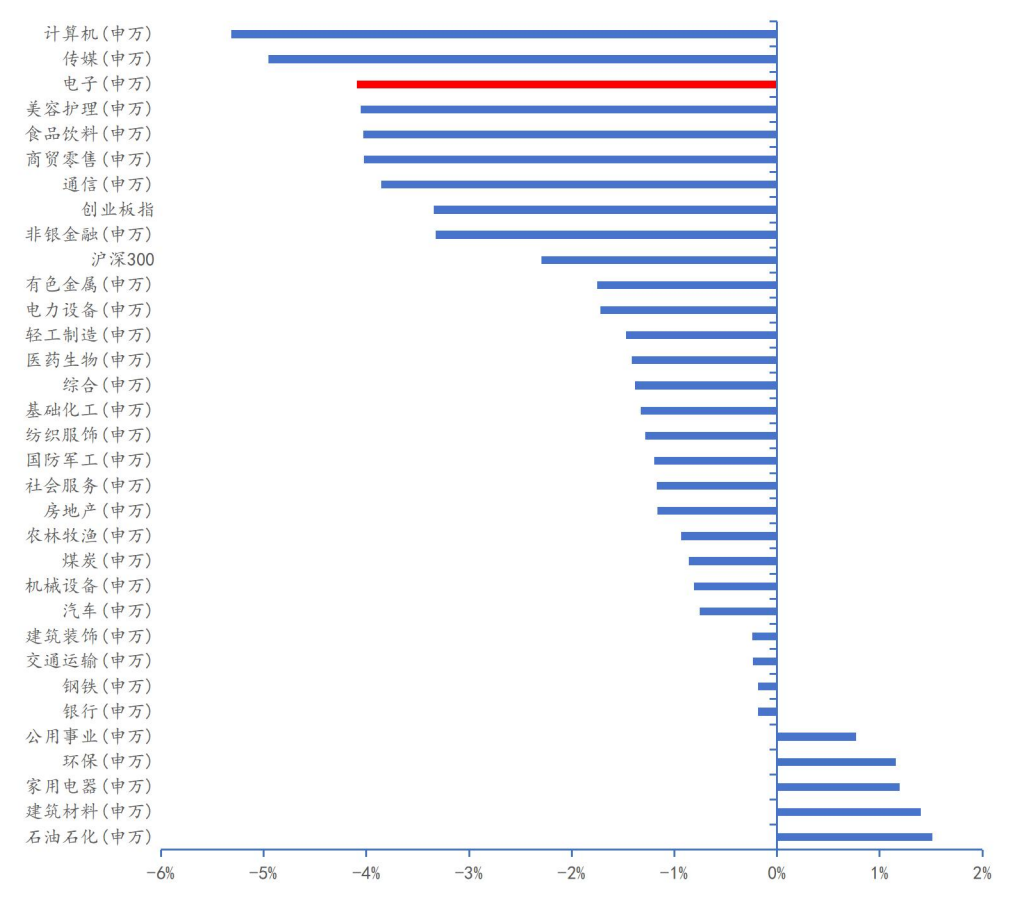
图表 10: 过去一周股权激励一览 18

1 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

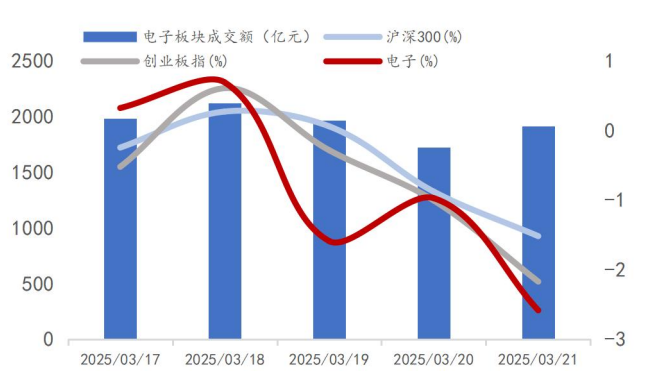
大盘表现上，本周（0317-0323）创业板指数下跌 3.34%，沪深 300 指数下跌 2.29%。本周电子行业指数下跌 4.09%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的倒数第 3 位，本周石油石化、建筑材料、家用电器涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



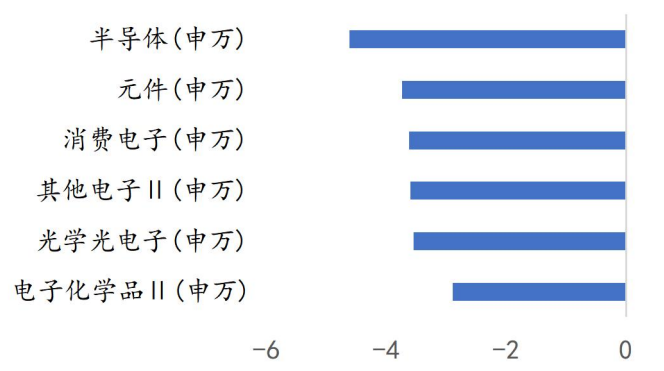
来源：Wind，华福证券研究所

图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



来源：Wind，华福证券研究所

图表 3：电子板块成交额及日涨跌幅



来源：Wind，华福证券研究所

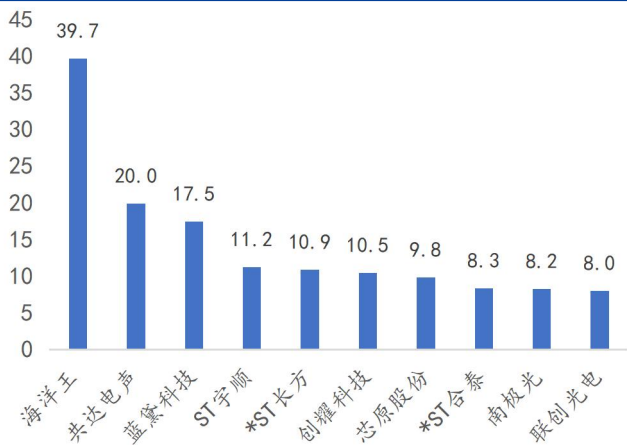
从电子细分行业指数看，本周电子细分板块普跌，具体来看，电子化学品跌幅

最小，周涨跌幅为-2.89%；半导体跌幅最大，周涨跌幅为-4.61%。

1.2 SW 电子个股本周表现

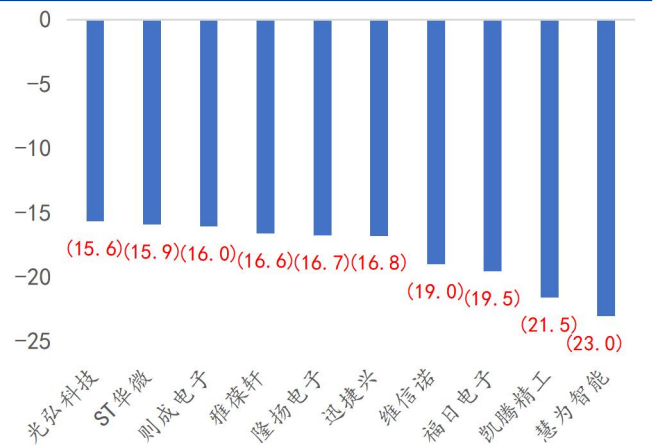
从个股维度来看，SW 电子板块中，海洋王（39.7%）、共达电声（20.0%）等位列涨幅前列；慧为智能（-23.0%）、凯腾精工（-21.5%）等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



来源: Wind, 华福证券研究所

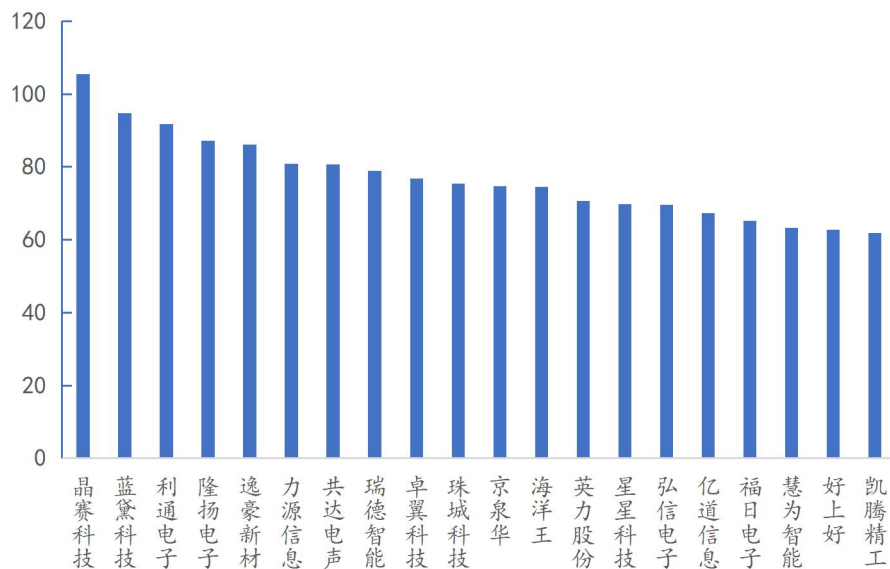
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看，本周电子行业个股换手率最高的是晶赛科技，换手率为 105.40%。其余换手率较高的还有蓝黛科技(94.78%)、利通电子(91.68%)、隆扬电子(87.23%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)



来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看，本周整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 57.71 倍，较上周微降。

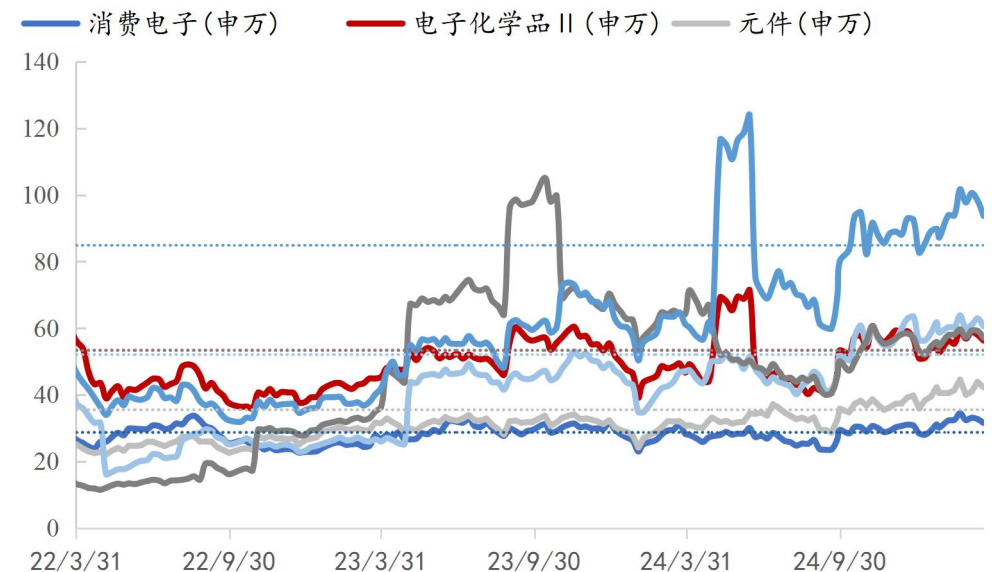
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上，本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 31.56、56.30、42.46、60.61、57.16 和 93.74。本周所有电子细分板块估值均出现下跌。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

2 行业动态跟踪

1) 2024 年我国数字产业 完成业务收入 35 万亿元

工业和信息化部 3 月 17 日发布的数据显示，2024 年，我国数字产业完成业务收入 35 万亿元，同比增长 5.5%；数字产业实现利润总额 2.7 万亿元，同比增长 3.5%；数字产业直接从业人员数达 2060 万人，与上年基本持平。

具体来看，重点行业平稳运行。数据显示，2024 年电子信息制造业全面回升向好。生产增长加快，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长 11.8%，

较上年提高 8.4 个百分点。消费电子市场全面回暖，拉动我国手机、微型计算机和彩电产量分别同比增长 7.8%、2.7%和 4.6%。在人工智能、云平台等新兴业务拉动下，软件业去年完成业务收入 13.7 万亿元，同比增长 10%。

数字基础设施量质齐升。截至 2024 年末，全国光缆线路总长度达 7288 万公里，累计建成 5G 基站 425.1 万个。全国在用算力中心标准机架数超过 880 万，算力总规模较上年末增长 16.5%。新型融合基础设施加速覆盖，累计建成 5G 虚拟专网 5.5 万个，广泛覆盖工业、港口、能源等重点应用场景。

产业集聚态势明显。2024 年，广东、江苏、北京、浙江、上海、山东、四川、福建、安徽和湖北等数字产业收入规模前 10 大省份占全国比重的 81.5%，对全国数字产业收入增长贡献率达 99.5%。围绕信息通信、人工智能、新型显示、集成电路等数字领域，已布局建设一批国家级先进制造业集群，成为数字产业发展的重要引擎。

值得一提的是，产业新动能持续增强。数据显示，“两重两新”政策拉动叠加全球市场需求复苏，电子信息制造业固定资产投资同比增长 12%。人工智能、人形机器人等新兴领域保持较高投融资热度，为产业发展持续注入活力。（资料来源：集微网）

2) 上海集成电路产业投资基金三期成立，出资额 5.3 亿元

企查查显示，3 月 14 日，上海集成电路产业投资基金三期合伙企业（有限合伙）注册成立，出资额为 53000 万元，执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司（委派代表：陈刚），经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

该企业由上海国有资本投资有限公司（认缴出资额 50000 万元）、上海集成电路产业投资基金管理有限公司共同出资（认缴出资额 3000 万元）。

企查查显示，上海集成电路产业投资基金管理有限公司“关联产品/机构”为上海集成电路产业投资基金。上海集成电路产业投资基金股份有限公司成立于 2016 年 12 月，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司成立于 2020 年 5 月。

2016 年 4 月 21 日，上海集成电路产业基金合作备忘录正式签署。据上海经信委当时消息，上海集成电路产业基金合作备忘录的签约标志着目前全国规模最大的集成电路产业基金顺利完成首期募资 285 亿元规模。该基金由市科创投集团、上汽集团、国家大基金等单位共同出资，重点投资集成电路制造业。各出资方已对出资份额、基金公司组建方案、章程等内容达成一致意见，基金公司已具备了组建条件。2016 年 12 月 7 日，上海集成电路产业投资基金股份有限公司成立。（资料来源：集微网）

3) 武汉促 IC 产业发展新政将出炉, 14nm 以下先进制程首轮流片最高 600 万元补助

2025 年 2 月 21 日, 武汉市经济和信息化局发布了《武汉市促进集成电路产业发展的若干政策措施(征求意见稿)》, 旨在进一步加快推动武汉市集成电路产业的高质量发展, 征求意见截止时间为 2025 年 3 月 23 日。

以下是该征求意见稿的具体内容:

为深入贯彻国家、省集成电路产业发展战略部署, 进一步推进我市集成电路产业高质量发展, 加快发展新质生产力, 结合工作实际, 制定以下政策措施。

第一条 适用主体

依法登记注册, 主营业务为集成电路设计、制造、封测、设备、零部件、材料、工业软件等环节的企业。依法登记注册的集成电路领域相关专业服务平台和投资机构。

第二条 支持设计环节创新发展

(一) 提升 IP 核、EDA 的设计支撑能力。对主营业务为集成电路 IP 核、EDA 工具且研发投入占营业收入比例达 15% 以上的企业, 按照不超过企业年研发投入的 10% 给予最高 200 万元补助。(责任单位: 市经信局)

(二) 支持集成电路产品首轮流片。对集成电路企业自主设计的新款产品首轮流片, 按照不超过该款产品首轮流片费用(含掩模版和 IP 购置费用)的 50%, 先进制程(14nm 工艺以下)的产品给予最高 600 万元补助, 成熟制程(14nm 工艺及以上)的产品给予最高 300 万元补助。(责任单位: 市经信局)

第三条 支持重点领域强链补链

(三) 支持企业开展车规级芯片认证。对首次完成 AEC-Q100 标准认证的企业, 按照认证费用 30% 给予一次性补贴, 最高补贴不超过 100 万元; 对首次完成 ISO26262 功能安全标准(含功能安全流程认证和功能安全产品认证)的企业, 按照认证费用 30% 给予一次性补贴, 最高补贴不超过 150 万元。(责任单位: 市经信局)

第四条 提升产业公共服务能力

(四) 支持公共服务平台建设。对经认定的提供 EDA 工具和 IP 租赁、设计解决方案、先进工艺流片、先进封装测试等服务为主的集成电路公共服务平台, 一次性给予平台实际建设投入 30% 的资助, 最高资助总额不超过 1000 万元。(责任单位: 市经信局)

(五) 支持中试平台积极发挥效能。支持中小企业在经认定的中试平台开展设备、零部件、材料的测试和验证, 推动新技术、新产品加快熟化。按照不超过测试验证费用的 30%, 给予设备、零部件、材料企业提供最高 300 万元补助。每家企业

年度补助总额最高 500 万元。（责任单位：市经信局、市科创局）

第五条 加强产业金融支持

（六）激发投资基金撬动作用。引导各类投资基金管理机构积极领投集成电路企业，鼓励 CVC（企业风险投资）母基金收购、并购国内外集成电路产业上下游企业。（责任单位：市经信局、市财政局、市委金融办、武汉投控集团、武汉金控集团）

第六条 鼓励人才引进培育

（七）培育孵化优质创业项目。聚焦高端光芯片、硅光半导体、量子芯片、先进封装、三维异构集成等未来产业前沿领域，孵化培育一批创业团队项目，对入选武汉市优秀集成电路创业团队项目的，给予最高 500 万元种子资金或 500 万元银行贷款额度贷款市场报价利率（LPR）的全额贴息或 1000 万元股权投资的支持。（责任单位：市经信局、市人才工作局、市科创局、市委金融办、武汉投控集团、武汉金控集团）

第七条 附则

本政策措施自印发之日起实施，有效期至 2027 年 12 月 31 日。《市人民政府关于印发武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策的通知》（武政规〔2020〕18 号）同时废止。本市其他文件与本政策有重叠、交叉的，按照“从优、从高、不重复”的原则执行。政策执行过程中，如遇国家、省、市有关政策及规定有调整的，适用调整后的有关政策及规定。（资料来源：集微网）

4) 苏州加快发展 AI 芯片产业专项政策将出炉，最高亿元资助

3 月 17 日，《苏州市加快发展 AI 芯片产业的若干措施（征求意见稿）》发布，旨在抢抓人工智能技术快速发展的机遇，加快推动 AI（人工智能）芯片产业创新发展。该文件由苏州市工信局牵头起草，现面向社会公开征求意见，截止时间为 2025 年 4 月 16 日。

以下为该征求意见稿的具体内容：

为抢抓人工智能技术快速迭代发展机遇期，充分发挥我市半导体与集成电路产业基础优势，加快推动 AI（人工智能）芯片产业创新突破、集聚成势，结合我市产业发展实际，制定本措施。

一、做强骨干核心企业。聚焦 GPU 通用型芯片、ASIC 专用型芯片、FPGA 半定制化芯片、存算一体芯片、硅光芯片等重点方向，加大招商力度，加快引育一批带动性强的优质项目、头部企业，对重点项目在空间保障、场地建设、人才引进等方面予以综合支持。推动 AI 芯片企业通过兼并重组等方式提升资源整合能力，向产

业链上下游布局拓展业务，对优质 AI 芯片企业开展并购重组，鼓励县级市（区）对企业实施兼并重组给予奖励。对 AI 芯片企业获评制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”，分别给予 100 万元、40 万元奖励。对获得认定的 AI 芯片高新技术企业，给予最高 100 万元支持。（责任单位：市工信局、市科技局、市发改委、市委人才办，各县级市<区>人民政府<管委会>）

二、布局建设创新平台。围绕 AI 芯片重点方向，加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，给予最高 200 万元运营经费支持。鼓励围绕 AI 芯片技术研发、成果转化等关键环节，建设 AI 芯片科技公共技术服务平台，对新建平台按总投资的 20% 给予最高 2000 万元支持。对为 AI 芯片设计企业提供 EDA 工具、系统级芯片（SoC）设计服务、多项目晶圆（MPW）、功能模拟、测试验证、“芯机”联动、快速封测、人才培养等专业化服务的平台，按照平台为本地企业提供服务收入的 20%，给予最高 300 万元奖励。（责任单位：市科技局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

三、集聚高端芯片人才。聚焦 AI 芯片领域，大力引进培养处于人工智能领域科技前沿和国际一流水平，掌握关键核心技术，能够带来重大影响、重大突破的海内外人才，给予 3000 万元~1 亿元项目资助和 300 万元~1000 万元购房补贴。在苏州创新创业领军人才计划中，每年专设 100 个左右“人工智能专项”名额，特别优秀的可突破学历、来苏州时间等限制，给予 100 万元~500 万元项目资助和 100 万元~200 万元购房补贴。对入选苏州市重点产业紧缺人才计划的人才，给予最高 30 万元薪酬补贴。推动建设集教育、培训及研究为一体的产学研融合协同的集成电路产业人才公共实训基地，在 AI 芯片领域打造全产业链高技能人才团队。（责任部门：市委人才办、市科技局、市人社局、市教育局、市工信局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

四、实现关键技术突破。梳理编制 AI 芯片关键核心技术清单，鼓励企业开展芯片架构、制程工艺、计算加速、异质集成、数据中心光模块等技术研究，对关键核心技术攻关项目给予最高 1000 万元支持。支持 AI 芯片设计企业开展拥有自主知识产权的工程流片验证，对首次流片、光罩制作以及测试验证等费用给予最高 50% 支持，工艺制程 12nm 以上的产品最高支持 500 万元，12nm 及以下的产品最高支持 1000 万元，鼓励有条件的县级市（区）给予联动支持。鼓励 AI 芯片企业提出技术需求，吸引国内外创新主体揭榜攻关，加快突破制约产业发展的技术瓶颈。（责任单位：市科技局、市工信局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

五、支持开展标准研制。健全 AI 领域技术创新、专利保护与标准化互动支撑机制，推动创新成果的知识产权化和技术标准化，为 AI 芯片技术专利申请、软件著作权登记提供便利化服务。发挥行业协会和标准化机构作用，支持 AI 芯片龙头企业、重点院校、科研机构主导和参与 AI 芯片行业标准制定（修订），经主管部门认定后，

按相应政策给予支持。支持组建芯片领域高价值专利培育中心，对成效明显的给予奖励。（责任部门：市市场监管局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

六、推进重点产品量产。围绕数据中心、计算机视觉、智能网联车、智能机器人、智能语音等主要应用领域，结合关键技术清单，鼓励创新主体通过产学研合作等方式推进重点产品规模化批量生产。对 AI 芯片 IDM（垂直整合制造模式）企业开发创新产品列入省重点推广应用新技术新产品目录的，给予一次性奖励 50 万元。在苏州市科技成果转化专项中对 AI 芯片企业给予倾斜支持，加快 AI 芯片重大创新产品培育，每个项目给予最高 2000 万元支持。鼓励支持保险机构探索 AI 芯片定制化保险产品，为企业研发、生产、销售等各环节提供保险保障。（责任单位：市工信局、市科技局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

七、加快产业协同联动。鼓励 AI 芯片设计企业与制造企业开展合作，支持封测企业扩大 AI 芯片产品布局。对为苏州市 AI 芯片设计企业自主研发产品提供生产线产能，并生产符合一定条件产品的集成电路制造、封测企业，按每款产品订单实际生产费用的 10% 最高给予 300 万元奖励。对使用本地企业 AI 芯片产品的终端厂商、系统方案集成商、算力中心，按当年使用金额的 10% 给予奖励，单个企业最高奖励 100 万元。对认定为省级、苏锡常首台（套）重大装备的半导体设备企业，分别给予 80 万元、50 万元奖励。对首年度生产销售重点新材料首批次应用示范指导目录内同品种、同技术参数的半导体新材料产品企业给予 50 万元奖励。组织开展“芯片—整机”“芯片—材料设备”等产业链上下游供需联动和产业对接，增强产业链协作能力。（责任单位：市工信局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

八、开放规模应用场景。鼓励政府机关、企事业单位开放应用场景，支持 AI 芯片企业积极参与政务服务、交通、环卫、公共安全、教育、医疗健康等领域应用，加快 AI 芯片产品新技术迭代、新产品应用、新场景落地，培育打造具有典型意义的标杆案例。构建芯片测评标准和适配认证体系，加速 AI 芯片在智算中心训练、推理等场景的规模化应用。鼓励 AI 芯片企业整合行业资源和高质量数据，针对场景需求开展 AI 芯片产品开发，形成可复制可推广的解决方案。（责任单位：市数据局、市交通局、市城管局、市公安局、市教育局、市卫健委、市工信局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

九、着力强化金融支撑。充分用好人工智能产业专项母基金，重点投向本土拥有关键核心技术、发展潜力大的 AI 芯片创新型企业，撬动社会资本投向 AI 芯片领域，支持 AI 芯片企业原始创新和成果转化。加强与国家、省集成电路产业投资基金对接，争取各级基金资源支持我市 AI 芯片产业发展。重点支持 AI 芯片领域专精特新企业、高新技术企业进入上市后备企业库，实施重点培育。积极落实集成电路企业税收优惠政策。（责任单位：市委金融办、市财政局、国家金融监管总局苏州分局、苏创投，各县级市<区>人民政府<管委会>）

十、打造多元产业生态。发挥“人工智能+”城市政策牵引作用，加快构建 AI 芯片设计企业、大模型推理及训练企业、智算及数据中心及终端应用企业深度合作生态。支持龙头企业牵头组建 AI 芯片行业生态联盟，举办产业链上下游对接交流活动，为企业搭建沟通平台。鼓励 AI 芯片领域行业联盟、行业协会、智库单位等行业组织加强能力建设，为行业提供专业化服务。搭建高层次交流合作平台，鼓励开放创新与全球合作，支持打造 AI 芯片领域品牌展会和论坛等活动。（责任单位：市发改委、市科技局、市工信局、市商务局，各县级市<区>人民政府<管委会>）

本文件所指 AI 芯片企业是在苏州依法登记注册，以 AI（人工智能）芯片设计、制造、封测等为主营业务的企业。本文件由苏州市人民政府负责解释，具体解释工作由市工业和信息化局会同相关部门承担。

本文件自 2025 年 X 月 X 日起施行，有效期至 2027 年 12 月 31 日。各部门政策所涉及资金按原渠道和财政体制要求落实。同一事项或项目符合市级财政多个支持政策的，均按照“就高、不重复”原则予以支持，不得重复申报。执行期间如遇上级有关政策规定调整的，从其规定。（资料来源：集微网）

5) 斯达半导体重庆车规级模块生产基地项目封顶，未来产能将达 180 万片

据西部重庆科学城消息，近日，斯达半导体重庆车规级模块生产基地项目在重庆高新区正式封顶，离未来达产 180 万片又近一步。

该项目由长安旗下的深蓝汽车与行业头部企业斯达半导体共同组建。一期产能 50 万片，二期将达到 180 万片。预计今年 5 月该项目将达到设备进场条件，6 月实现小批量生产。

据悉，2023 年，深蓝汽车科技有限公司与嘉兴斯达半导体股份有限公司成立有公司合作组建重庆安达半导体有限公司，双方围绕车规级功率半导体模块开展合作，共同推进下一代功率半导体在新能源汽车领域的商业化应用，助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群。

西部重庆科学城消息指出，斯达半导体是国内新能源汽车大功率车规级功率模块的主要供应商，是国内 IGBT 行业的领军企业，2024 年配套超过 400 万辆新能源汽车，年度 IGBT 模块的全球市场份额占有率国际排名第四，在国内排名第一。

据安达半导体相关负责人介绍，该项目将增强深蓝汽车的供应链垂直整合能力，为其达成百万级战略销量目标提供扎实支撑；另一方面还将加速双方在“产研供需”方面的优势互补，合力打造高品质产品。

2023 年 5 月，斯达半导体重庆车规级模块生产基地项目签约。

2023 年 6 月 20 日，西部科学城重庆高新区重点产业项目集中开工活动举行，包括斯达半导体重庆车规级模块生产基地。当时消息显示，斯达半导体重庆车规级

模块生产基地项目总投资 4 亿元，预计 2025 年达产，达产后年产值约 10 亿元。（资料来源：集微网）

6) 投资已超 10 亿元，宁波冠石半导体光掩模版制造项目通线

据宁波前湾新区发布消息，3 月 19 日上午，宁波冠石半导体光掩模版制造项目举行新品发布暨通线活动。

宁波冠石半导体是一家专业从事半导体光掩模版制造的企业。宁波冠石光掩模版制造项目 2023 年 5 月 16 日签约，同年 10 月 1 日落地开工，2024 年 1 月 27 日落成结顶，如今项目通线投产，用时不到两年，完成固定资产投资超 10 亿元，亩均有效投资强度超 1500 万元。

2024 年 7 月消息，宁波冠石半导体有限公司迎来关键节点，该企业引入首台电子束掩模版光刻机。据悉，该设备是光掩模版 40 纳米技术节点量产及 28 纳米技术节点研发的重点设备。

据悉，光掩模版是微电子制造中光刻工艺所使用的图形转移工具或母版，其功能类似于相机的“底片”。作为半导体产业链上游重要的原材料之一，光掩模版是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。目前，我国高精度半导体光掩模版产品主要仍依赖于进口，国产化率极低。

目前，宁波冠石已实现 55nm 光掩模版产品交付及 40nm 产线通线，该企业产品将广泛应用于人工智能、高性能计算、新能源汽车、消费电子等集成电路制造领域。（资料来源：集微网）

7) 里程碑！京东方华灿 Micro LED 工厂产品正式交付

3 月 19 日，京东方华灿举行了 Micro LED 工厂产品交付仪式。京东方华灿宣布 Micro LED 量产产品全面交付，象征着其完成 Micro LED 芯片从研发、试量产，稳定量产到商业化落地的关键里程碑。京东方华灿同步公布了 Micro LED 产品的产能规划，预计 2025 年实现 Micro LED 晶圆（COW）产能 1000 套（RGB）/月，Micro LED 像素器件（MPD）产能 2500kk 颗/月，可应用于大尺寸商用显示、AR/VR 头戴式显示设备、ADB 车灯、可穿戴设备等应用领域，将进一步推动 Micro LED 技术的规模化应用，助力行业快速发展。

同时，京东方华灿表示，未来将根据市场需求变动，或将进行二期扩产，产能可实现翻倍递增。

2024 年 11 月 6 日，京东方华灿 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目投产仪式在珠海举行。该项目是全球首个实现规模化量产的 Micro LED 生产线，也是全球首条 6 英寸 Micro LED 生产线。当时公开消息显示，该项目自 2023 年 7 月底正式动工以来，历经项目封顶、工艺设备搬入、产品点亮等重要节点，仅用 16 个月就

实现项目投产，成为全球首条 6 英寸 Micro LED 量产产线，同时也是同行业第一个实现产线自动化的 Micro LED 芯片制造工厂，在 MPD（Micro LED 像素组件）封装、巨量转移、色彩转换等方面具有显著技术优势。

据悉，京东方华灿全球首条规模化量产 6 英寸 Micro LED 生产线项目规划面积 500 亩，目前落成的基地为一期项目，占地约 217 亩，投资金额约 23 亿，主要产品为 Micro LED 晶圆/像素器件；二期项目占地约 120 亩，主要生产 Mini/Micro 显示产品，为客户提供整体解决方案。未来，随着两期项目全部完成，将实现 Micro LED 晶圆 24000 片组/年（6 英寸），Micro LED 像素器件 45000kk/年，即折合 6 英寸片总产能约 3 万片/月的生产能力。（资料来源：集微网）

8) 华大九天拟购买芯和半导体控股权

3 月 17 日上午，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”）股票临时停牌。午间，该公司发布公告，宣布停牌原因，系正在筹划以发行股份及支付现金等方式购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司的控股权。

该公告称，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为上海卓和信息咨询有限公司、上海翔文敏慎信息咨询有限公司、上海和能企业管理中心（有限合伙）、上海言慎企业管理中心（有限合伙）、上海奕蒂能企业管理中心（有限合伙）、上海斐特嘉企业管理中心（有限合伙）、上海斐而特企业管理中心（有限合伙）、上海美能企业管理中心（有限合伙），但本次交易对方的范围尚未最终确定。

华大九天是国产 EDA 领军企业，是唯一能够提供模拟电路设计全流程 EDA 工具系统的国内企业，在国产 EDA 企业中保持工具链覆盖率领先。

芯和半导体科技（上海）股份有限公司（以下简称“芯和半导体”）创建于 2010 年，是一家从事电子设计自动化（EDA）软件工具研发的高新技术企业，围绕“STCO（系统工艺联合优化）集成系统设计”进行战略布局，开发 SI/PI/电磁/电热/应力等多物理引擎技术，以“仿真驱动设计”的理念，提供从芯片、封装、模组、PCB 板级、互连到整机系统的全栈集成系统 EDA 解决方案，支持 Chiplet（芯粒）先进封装，致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计，已在 5G、智能手机、物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用。

据悉，华大九天已与本次交易的主要交易对方签署意向协议，初步达成购买资产意向。本次交易的具体方案待由协议各方及标的公司股东进一步协商确定，并签署正式股份收购协议。（资料来源：集微网）

9) 汇顶科技任命柳玉平为新总裁

3 月 21 日，汇顶科技发布公告称，为满足公司发展的需要，经公司首席执行官

提名、董事会提名委员会资格审核，公司聘任柳玉平先生为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事长兼首席执行官张帆汇报，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

资料显示，柳玉平，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2015年1月，历任深圳市汇顶科技股份有限公司研发工程师、项目经理、质量部经理、工程部总监等职务；2015年1月至2022年5月，历任深圳市汇顶科技股份有限公司副总裁、供应链负责人、产品线负责人。2025年3月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司总裁。

不久前，汇顶科技发布公告称，公司董事会于近日收到公司总裁胡煜华女士的书面辞职报告。胡煜华女士因个人原因，申请辞去公司总裁职务。辞职后，胡煜华女士将不再担任公司任何职务。（资料来源：集微网）

10) 小米计划扩建北京第二电动汽车工厂，年交付目标提升至35万辆

知情人士透露，小米公司正在扩大计划中的北京第二家电动汽车工厂的规模，此前其首款车型的成功促使小米CEO雷军将今年汽车的销售目标提高到35万辆。

小米公司于2024年开始在北京亦庄区一块占地53公顷（131英亩）的土地上建造第二家工厂，这块土地是该公司以8.42亿元人民币（1.16亿美元）购买的。该工厂将于今年年中投产。

知情人士表示，最新的扩建将使该工厂占据一块约52公顷的相邻地块。

小米第一家汽车工厂的设计年产能约为15万辆，不过该公司已采取措施，包括优化工作流程来提高产量，以帮助填补积压订单。雷军此前曾设定今年交付30万辆汽车的目标。

该计划出台之际，小米的SU7电动轿车及SU7 Ultra赛车版受到买家的欢迎，不到一年的交付量就超过20万辆。小米运动型多用途车（SUV）YU7将于今年夏季推出，以扩大小米的产品线，并与特斯拉的Model Y和其他竞争激烈的对手展开较量。

电动汽车业务帮助小米公司实现了自2021年以来最快的收入增长，2024年第四季度利润增长90%，大幅超出分析师预期。

凭借出色的表现，小米公司的股价在过去一年中上涨三倍。（资料来源：集微网）

11) 魅杰光电获数千万元融资，聚焦半导体量检测设备赛道

据毅达资本消息，近日，毅达资本完成对魅杰光电科技（上海）有限公司（以下简称“魅杰光电”）数千万元领投。本轮融资资金将用于魅杰光电在产品研发、

团队扩充及市场拓展方面的投入，进一步增强该公司在半导体量检测设备领域的产品竞争优势。

魅杰光电成立于 2015 年，专注于半导体量检测设备的研发与制造。魅杰光电核心团队由半导体行业资深专家组成，创始人温任华拥有丰富的行业经验和背景，带领团队在套刻设备、缺陷检测设备等领域取得了显著突破。

毅达资本消息指出，目前，魅杰光电已成功推出多款量检测设备，广泛应用于 8 寸和 12 寸半导体生产线，并与国内多家头部半导体厂商建立了紧密的合作关系。该公司也正在研发先进制程量检测设备，预计未来两年内交付样机，进一步推动国产半导体量检测设备的技术升级。

今年 1 月，投资 8.5 亿元的魅杰光电科技总部项目正式签约落地无锡，将在蠡园开发区落地公司总部，建设半导体量检测设备研发制造基地。（资料来源：集微网）

12) 松应科技完成数千万元天使轮融资，系实时物理 AI 仿真平台公司

据中科创星消息，松应科技于近日宣布完成天使轮融资，由中科创星领投，上海天使会、接力天使、奇绩创坛跟投，融资资金将用于团队建设和扩大研发。

松应科技核心技术团队来自华为、海思、英特尔、腾讯等，拥有 10 年以上相关前沿行业的技术研发和产品工程经验，自主研发的物理 AI 仿真系统 ORCA，为 AI 与物理实体产业连接架起桥梁。

松应科技已服务国家级人形机器人创新中心、具身智能厂商、高校、科研院所等领域内的多家头部客户，并与多家国产 GPU 厂商达成战略合作。此外，作为重要的基础软件与高质量合成数据供应商，松应科技作为语料工作委员会成员，亦参与了上海市智能算力资源统筹调度服务平台的建设。

ORCA 底层支持异构国产 GPU、接入机器人各种传感器，中间层支持各种机器人仿真软件、AI 生成技术，上层致力于构建开发者生态和不断积累场景资产，是目前行业唯一兼容多硬件架构的物理 AI 仿真平台。

中科创星表示，物理 AI 仿真是具身智能规模化落地的核心引擎。松应科技历时三年，自主研发了物理 AI 真系统 ORCA，通过高精度虚拟环境生成多模态合成数据，覆盖人形机器人运动控制、环境交互、传感器模拟等场景，支持动态物理场模拟与实时数据合成，可大幅提升具身智能大脑训练效率的同时降低训练成本。同时，ORCA 底层兼容英伟达及国产多类 GPU 硬件，适配主流工业软件接口，上层支持的物理仿真、强化学习、数字场景并且构建开发者协作生态，处于非常核心的生态位，我们期待公司利用技术优势，助推机器人等行业快速发展，不断构建 ORCA 系统的软硬件生态壁垒。